



芯片返修站

■ 产品用途

返修各类芯片，如：BGA、PLCC、QFP、QFN、CSP、FBGA、PBGA等

■ 产品特点

- 顶部加热：红外+热风，混合加热器双温区独立控制，可进行有效的热传递
- 底部加热：三个加热区的底部红外，每个加热器可独立控制
- 冷却方式：顶部+底部强制冷却，采用压缩空气
- 测温方式：内置无线红外测温，外置2个TC测温端口，实现温度闭环控制
- 芯片的拆卸和焊接温度标准曲线，可实时的检查、测试和控制
- 加热器/贴装头：自动上升/下降，感应式预压回弹装置，贴装头可360°旋转
- 芯片贴装/移除：自动模式，步骤模式；轴移动方式，手动与电动结合
- 对位系统：LED照明亮度可调，无极放大，自动对焦，“OK”报警提示
- 助焊剂/锡膏：通过供料器自动蘸涂在芯片底部
- 焊接过程视频监控系统：1000万像素高分辨率摄像机，监控焊接过程的变化
- 数据追溯系统：记录芯片的工艺数据和加热数据。（数据包含：实测温度曲线、预设温度曲线、加热过程数据，工艺要求和设备状态记录）

■ 产品规格

| 型号 | 品牌 | 底部发热器 | 顶部加热器 | 温度传感器 | PCB尺寸 mm | 芯片尺寸 mm | 贴装精度 um | 对位相机 | 工艺相机 |
|---------|------|---|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|----------------------------|
| HR500 | ERSA | 尺寸：270 x 270 mm 功率：800W×2=1600W 加热方式：中波红外陶瓷 | 尺寸：20~70mm 功率：450W×2=900W 加热方式：热风+红外 | 红外测温 K型热电偶2个 AccuTC测温棒 | 380x300 H=6 | 1 x 1 至 50 x 50 | / | 500万像素 USB2.0 LED照明 | 230万像素 USB2.0 LED照明 |
| HR600/2 | ERSA | 尺寸：380 x 250 mm 功率：800W×3=2400W 加热方式：中波红外陶瓷 | 尺寸：20~60mm 功率：400W×2=800W 加热方式：热风+红外 | 红外测温 K型热电偶2个 AccuTC测温棒 | 390x285 H=6 | 1 x 1 至 50 x 50 | ±25 | 130万像素 USB2.0 LED照明 | 1000万像素 USB2.0 LED照明 |
| HR600XL | ERSA | 尺寸：625 x 625 mm 功率：15KW 或 30KW 加热方式：中波红外陶瓷 | 尺寸：20~60mm 功率：800W 或 2800W 加热方式：热风+红外 | 红外测温 K型热电偶3个 AccuTC测温棒 | 625x625 625x1250 H=10 | 0.5 x 0.5 至 60 x 60 | ±25 | 500万像素 USB2.0 LED照明 | 500万像素 USB2.0 LED照明 |